

質疑応答

説明会概要

2021年5月12日(水) 16:00-17:00

Zoom ウェビナー

機関投資家・アナリスト向け

質問1. 営業利益が前年同期比95.5%増と大きく増加した背景は。

回答 Q1は人財採用が計画どおり進まず販管費が抑えられた。売上拡大で生産数量が増加している。当期は製造部門や研究開発部門等の人員を増強する計画である。

質問2. 主要製品の売上が伸びている要因は。

回答 「CZ」はPC、タブレットPCの需要の強さを背景にパッケージ基板(PKG)が好調。半導体は需給がひっ迫するくらい量が増加していてPKGも不足しているといわれている。半導体メーカーもPKGメーカーも積極的に投資をしている。「SF」はタブレットPCの需要によるもの。「EXE」はディスプレイの売れ行きが当初の想定よりもいい状況にある。「V-Bond」はクルマ用基板やスマートフォン用基板がよかった。

質問3. 当期業績予想について、売上が上期より下期が減少する理由は。

回答 Q1の売上は想定よりも大きく上振れた。今後は、タブレットPCの需要やクルマ市場の動向等不透明な部分もあり、下期は期初計画を据え置くこととした。

質問4. 原材料費の上昇など、懸念材料はあるのか。

回答 一部の原材料費で上昇しているものはあるが、粗利に影響するほどでない。

質問5. 薬品出荷量が増加する傾向にあるが、生産能力の状況は。

回答 確かに出荷数量は増えている。色々なことを考えながら投資についても検討していきたい。今のところ生産設備能力は十分カバーできる。

質問6. 当Q1の販管費比率は低かったが、今後も抑えていくのか。

回答 抑えられるところは抑えていくが、今の状況では人財拡充は必須と思っている。いい人財を確保していきたい。一方、例えば、出張旅費など押さえ抑えられるところは抑えていく。当社は無駄な費用は使用しないということを基本に今日に至っているの、特別に抑え込むということも考えてない。必要などころにはきっちり使用していきたい。

質問7. 2.5Dパッケージ基板は大型化・多層化で面積が増加するということだが、3Dパッケージ基板ではどうか。

回答 3Dパッケージ基板も同様に増加する。2.5Dはサーバー向け、3DはPC向けになるであろう。

質問8. CO2削減に対する取組みについて教えてほしい。

回答 今後の課題となる。CO2の部分を切り出して、例えばそれを当社の中で減らす等まだ具体的にはできていない。漠然としているが、例えば、基板製造工程において歩留まりを向上させる、生産性を向上させるという中で、間違いなく顧客側のCO2削減や廃材を低減等の面で寄与できていると思う。具体的に定量的に説明できる状況にはまだない。

以上